



◎回路積層技術の生産および技術移転が可能に

仏ソイテク・グループ

【ベルナン（フランス） 27日PRN=共同JBN】 マイクロエレクトロニクス用加工基板における世界最大手のサプライアである、フランスのソイテク・グループ（ユーロネクスト・パリ）は、27日、同社独自の回路積層（スタッキング）技術「スマート・スタッキング（Smart Stacking、商標）」の生産および技術移転の準備が整った、と発表した。同社トラシット（Tracit）事業部門におけるこの低温製造プロセスは、一連の基板材料の上で、ウエハーレベルでの回路積層を優れた歩留まりで実現する。完成した回路を、歩留まりを損なうことなく別の基板に移し換えることができることは、設計者に新たな可能性を与える。現在、スマート・スタッキングはハイエンド・画像センサーの生産に用いられているが、新しいフォトリソグラフィ・アプリケーション、無線（RF）回路、究極的には、さらに複雑な3次元（3D）製品のアーキテクチャーにも適用可能である。

ソイテクは、回路の製造をアプリケーション・ニーズと独立にするため、プロセスを経たウエハーの素子薄膜層を、さまざまな基板材料の上に移すことのできる、この汎用性のある製造方法を開発した。スマート・スタッキング技術は、低温・高エネルギーのウエハー接着、および薄膜化技術で構成され、共に同社の量産ノウハウにより肉付けがなされている。同社は、世界中の多くのファウンドリ、IDM（垂直統合型企業）から寄せられた種々のウエハー構造に対して、最先端製造ラインを用い、プロトタイプ製造、およびその生産に成功したと報告している。

トラシット事業部門のベルナル・アスパ副社長は「世界クラスの製造能力、有効なIP、および長年にわたる経験に基づき、ソイテクは、独自の方法によるスマート・スタッキング回路積層技術を提供する」と語った。同氏はまた「少量のアプリケーションには、顧客ごとに最適化された回路積層技術サービスを提供し、数量の多いアプリケーションには、最適化された製造方法を顧客に技術移転し、その結果、流通の簡素化、コスト削減、およびサイクルタイムの短縮を図って頂くのが良い、と考えている。従って、当社は製造サービスと技術ライセンス供与の両方のオプションを提供する。」と語った。

ソイテク・グループは（元は良く知られたCEA-LETI・マイクロエレクトロニクス研究所のスピノフである）トラシット（Tracit）を2006年に買収した。今回の発表は、この戦略的、補完的買収の有効性を示すものであり、同時に、ブレイクスルー技術の創出によって、量産、ライセンス供与、および技術革新をもたらすという同グループの総合戦略を実証するものである。

フランスの独立系半導体市場調査会社ヨール・ディベロップメントによる最近の3次元ICに関する調査によると、ウエハーレベルの薄膜転写の需要は、主には画像センサーの応用により、2010年から2011年にかけてかなりの規模に達すると予想されている。

ヨール・ディベロップメント共同創立者であるエリック・ムニエ博士は、「メモリー、ロジック、パワーIC、アナログなど異種チップの3次元集積化が始まる2012年までには、機能の混合、技術の統合が進み、ソイテクの回路積層技術は、デバイスの設計および製造をさらに簡素化するだろう」と語った。

▽ソイテク・グループ (Soitec Group) について

ソイテク・グループは、今日の最先端マイクロエレクトロニクス製品の基盤をなす加工基板ソリューションの創出、提供によって世界をリードする。同グループは、独自技術である「スマートカット (Smart Cut、商標)」を最大限に活用することにより、この技術の最初の量産応用となったSOI (シリコン・オン・インシュレーター) ウエハーなど、新しい基板のソリューションを提供する。SOIはその後、高性能、高速、より低消費電力のチップを生産可能にし、未来に向けてのプラットフォームとなった。

現在、ソイテクは世界のSOIウエハーの80%強を生産している。ソイテクは本社をフランス・ベルナンに置き、現地に2つの量産工場がある。同社は米国、日本、台湾にオフィスがあり、さらにシンガポールには、顧客認定中の新しい生産設備がある。

ピコギガ・インターナショナル (レジュリス) とトラシット・テクノロジーズ (ベルナン) の両部門はソイテク・グループを補完する。ピコギガはIII-V族エピウエハーやGaN (ガリウムナイトライド) ウエハーなど先端基板ソリューションを、高周波エレクトロニクスやその他のオプトエレクトロニクス機器に向けた化合物半導体の領域で提供する。一方、トラシットは、パワーICとマイクロシステム向けに、先端基板製造に使用する薄膜層転写技術、および画像センサー、3D集積化に向けて、汎用性のある回路転写技術「スマート・スタッキング」を提供する。ソイテク・グループの株式はユーロネクスト・パリに上場されている。詳しい情報はウェブサイト (<http://www.soitec.com>) を参照。

Soitec, Smart Cut, UNIBONDはS.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologiesの商標である。

メディア連絡先 : Camille Darnaud-Dufour

Tel (France): +33-(0)6-79-49-51-43

E-mail: camille.darnaud-dufour@soitec.com

(了)